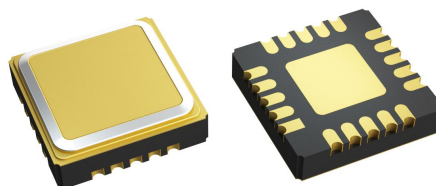


特点:

- 频率范围: 100~520MHz
- 插入损耗: 典型值 0.2dB
- 限幅电平: 典型值+15dBm
- 最大输入功率: +30dBm
- QFN 封装
- 尺寸: 4.0×4.0×1.5mm

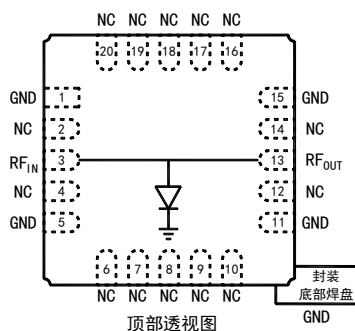
图片:



性能参数: (50Ω系统, T_A=-55~+85℃)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	f=100~520MHz P _{in} =0dBm	100		520	MHz	
插入损耗	IL			0.2	0.3	dB	
输入驻波	VSWR _I			1.1:1	1.5:1		
输出驻波	VSWR _O			1.1:1	1.5:1		
输入 P ₁	IP ₁		+9	+10		dBm	
限幅输出电平	P _{out}			+15	+16	dBm	
最大输入功率	P _{in}				+30	dBm	
质量	m				1.0	g	

功能框图:



极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+30dBm
装配温度	+260℃, 20s
工作温度	-55~+85℃
贮存温度	-55~+125℃
静电放电敏感度等级	1C

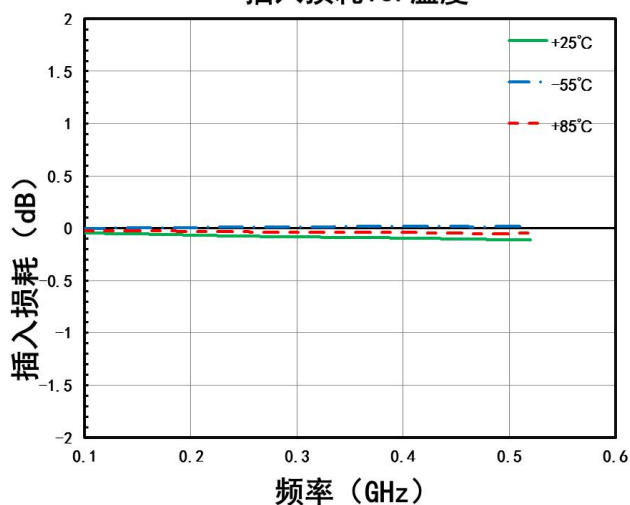
超过以上条件, 可能引起器件永久损坏。

引脚定义:

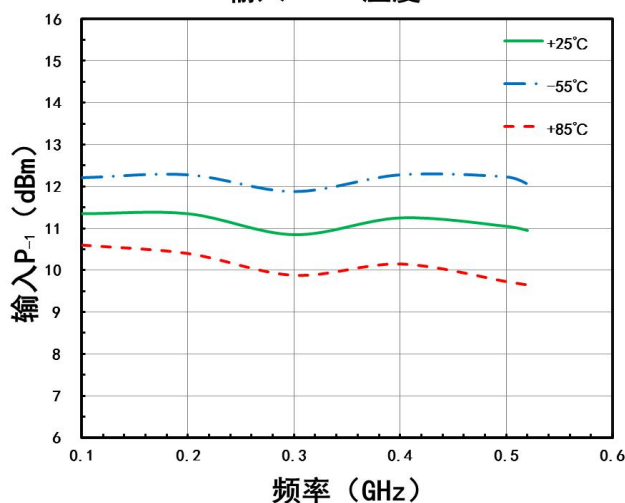
引脚编号	符号	描述
3	RF _{IN}	射频输入端口, DC 耦合
13	RF _{OUT}	射频输出端口, DC 耦合
1/5/11/15	GND	接地
底部中央焊盘	GND	接地
其它	NC	悬空



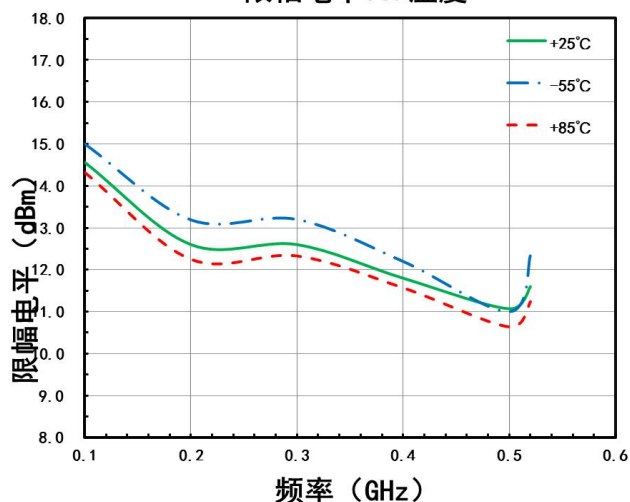
插入损耗VS. 温度



输入P₋₁ VS. 温度

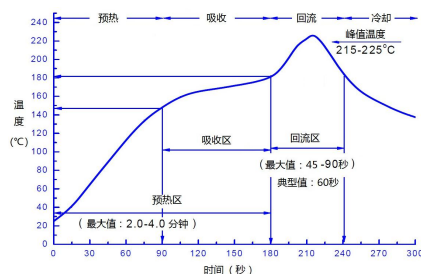


限幅电平VS. 温度



产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点+183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过极限参数中的装配温度。

4. 如特殊情况需采用手工补焊，烙铁温度+350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度+10~+35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。